

# 制造能力

## 产线规模



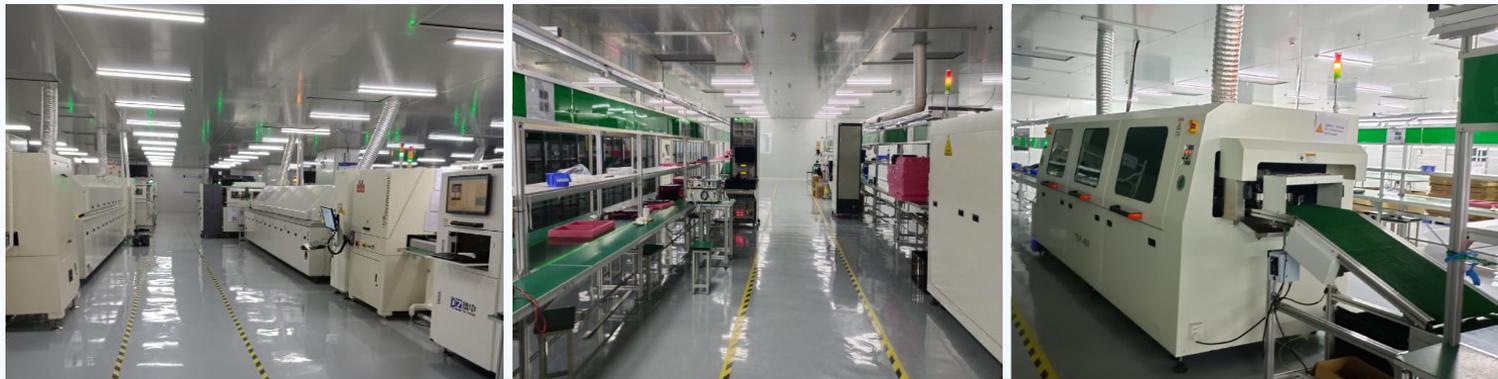
- (1) 20条ASM高端SMT线
- (2) 6条Panasonic自动插件机
- (3) 5条无铅波峰焊线
- (4) 15条测试组装线, 5条包装线
- (5) 每小时实际贴片能力300万点左右, 月产能可达15亿点

## 产线规模



- (1) 所有设备都可连接MES系统
- (2) 每条SMT线均配有SPI/AOI检测设备
- (3) 每条SMT线均配有SPI/AOI后NG-Buffer以实现全自动化连线生产
- (4) 1+1、2+1、3+1、双轨的产线布局，可以满足不同产品的生产需求，合理优化
- (5) 回流焊10温区，可充氮气

## 设备能力

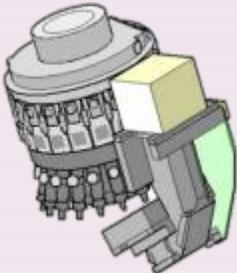


设备 工艺 能力	最小贴装压力	最大PCB尺寸	最小元器件	贴片元器件包装方式
	1.3N	610mm*510mm	01005 (部分设备03105)	Tape/Track/Tray
	插件角度	最小引脚间距	最大元器件 (长*宽*高)	回流焊温区
	0°, 90°, 180°, 270°	0.3mm (部分设备0.1mm)	200mm*125mm*25mm	10温区

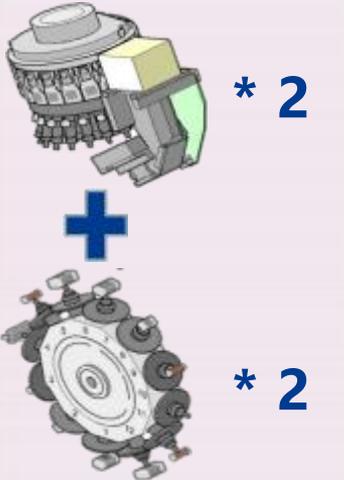
## 典型 3+1 SMT产线配置



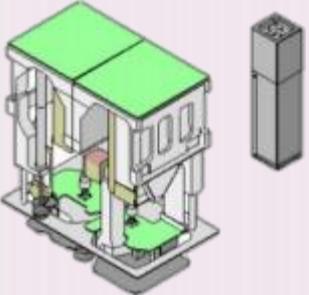
## 工艺主要设备

	贴片机 ASM DX4	贴片头CP20A*4	贴片头参数
<p>设备照片</p>		 <p>* 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 元器件尺寸范围：01005-6mm*6mm*4mm</li> <li>2. 引脚最小间距：0.25mm</li> <li>3. 贴装压力：1.5-4.5N</li> <li>4. 贴片精度：±36μm/3σ</li> <li>5. 角精度：±0,5°/3σ</li> </ol>
<p>设备参数</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.贴装PCB尺寸范围：50mmx50mm-610mmx510mm</li> <li>2.基准产能：150000点/小时</li> </ol>		

## 工艺主要设备

	贴片机 ASM DX4	贴片头 CP20A*2+CPP*2	贴片头参数
设备照片			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 元器件尺寸范围：01005-50mm*40mm*11.5mm</li> <li>2. 引脚最小间距：0.25mm</li> <li>3. 贴装压力：1.0-10.0N</li> <li>4. 贴片精度：±36μm/3σ</li> <li>5. 角精度：±0,5°/3σ</li> </ol>
设备参数	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.贴装PCB尺寸范围：50mmx50mm-610mmx510mm</li> <li>2.基准产能：90000点/小时</li> </ol>		

## 工艺主要设备

	多功能贴片机X4	贴片头TH*2	贴片头参数
设备照片		 <p style="text-align: center;">* 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 元器件尺寸范围：0402-200mm*125mm*25mm</li> <li>2. 引脚最小间距：0.25mm</li> <li>3. 贴装压力：1-15（可扩展为2-30）</li> <li>4. 贴片精度：<math>\pm 22 \mu\text{m}/3\sigma</math></li> <li>5. 角精度：<math>\pm 0.05^\circ/3\sigma</math></li> </ol>
设备参数	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.贴装PCB尺寸范围：50mmx50mm-610mmx510mm</li> <li>2.基准产能：11000点/小时</li> </ol>		

## 工艺主要设备

### 插件机 1

### 插件机 2

设备照片



设备参数

1. 可适应PCB或工装尺寸：50mm\*50mm-508mm\*381mm
2. 最大装料数120站
3. 插件速度0.12S/点
4. 插入角度：0°，90°，180°，270°

1. 可适应PCB或工装尺寸：50mm\*50mm-508mm\*381mm
2. 最大装料数80站
3. 插件速度0.29S/点
4. 插入角度：0°，90°

## 工艺主要设备

	设备照片	设备参数
回流焊		<ol style="list-style-type: none"><li>1. 10温区，可充氮气</li><li>2. 全热风回流传热快，热补偿效率高，<math>\Delta t</math> 小于<math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math>焊接均匀</li><li>3. 高温可达<math>235^{\circ}\text{C}</math>-<math>245^{\circ}\text{C}</math>,可承受<math>350^{\circ}\text{C}</math></li><li>4. 存储超过500个程式和500个温度曲线</li><li>5. 最大PCB宽度：600mm</li><li>6. 最大PCB高度：39mm</li></ol>

## 工艺主要设备

印刷机

分板波峰焊

设备名称	DESEN	EM-5700N	Topsmt WS350
设备照片			
产效性能	0.64mm/s-305 mm/s	/	/
PCB尺寸规格	最大尺寸: 609.8mm*508mm 厚度:0.2mm-5.0mm 最大重量: 4.5KG	最大PCB尺寸: 350mm*350mm	最大PCB宽度: 610mm
精度	± 12.5μm/6σ	/	/

感谢您的观看!